

特点(Feature)

- 无卤，无铅Halogen free,Lead-free
- 密度为1.4g/cm³ The density was 1.4g/cm³
- 良好的加工性 Excellent processability
- 一种轻质板材料 A light board material

性能(Laminate properties)

	Test Item 测试项目	Test Method (IPC-TM-650) 测试方法	Test Condition 处理条件	Unit 单位	Specification 规格值 (IPC-4101E/92)	Typical Value 典型值
Thermal 热性能	Thermal Stress 热应力	2.4.13.1	Float 288 °C/ Unetched	Sec	≥10	≥240
	Glass Transition (Tg) 玻璃化转变温度	2.4.25	E-2/105 DSC	°C	≥110	125
	CTE/ Z-Axis Expansion Z-轴热膨胀系数	2.4.24	Alpha 1	ppm/°C	≤60	43
			Alpha 2		≤300	263
	X/Y CTE X/Y-轴热膨胀系数	2.4.24	40 °C - 125 °C	ppm/°C	—	12/14
	T-260	2.4.24.1	TMA	min	≥30	>60
	T-288	2.4.24.1	TMA	min	≥15	>30
TD(5% weight loss)	2.4.24.6	TGA	°C	>340	322	
Mechanical 机械性能	Peel Strength (1 oz.) 铜箔剥离强度		Float 288 °C/ 10 Sec	N/mm	≥1.05	1.3
	Flexural Strength 弯曲强度	2.4.4	Length Direction	N/mm ²	≥415	543
			Cross Direction		≥345	482
Moisture Absorption 吸水率	2.6.2.1	D-24/23	%	≤0.5	0.09	
Electrical 电性能	Surface Resistivity 表面电阻	2.5.17.1	C-96/35/90	MΩ	≥10 ⁴	>10 ⁹
	Volume Resistivity 体积电阻	2.5.17.1	C-96/35/90	MΩ-cm	≥10 ⁶	>10 ¹⁰
	Dielectric Breakdown 击穿电压	2.5.6	D-48/ 50+D0.5/ 23	kV	≥40	61
	CTI 相对漏电起痕指数	IEC60112	A	V	—	>175
	Arc Resistance 耐电弧性	2.5.1	D-48/ 50+D-0.5/ 23	Sec	≥60	123